

吸収分割に係る事前開示書面（変更）

（会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める書面）

2020 年 5 月 19 日

パナソニック株式会社

2020 年 5 月 19 日

吸収分割に係る事前開示書面（変更）

大阪府門真市大字門真 1006 番地

パナソニック株式会社

代表取締役 津賀 一宏



印

当会社は、パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社（本店所在地：京都府長岡京市神足焼町 1 番地、以下「分割承継会社」といいます。）との間で吸収分割契約（以下「本件吸収分割契約」といい、本件吸収分割契約に基づき行う吸収分割を「本件分割」といいます。）を締結し、2020 年 4 月 2 日付で会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に基づく事前開示を行いました。2020 年 5 月 18 日付で本件分割の承継対象権利義務の一部の変更に係る吸収分割契約変更契約を締結したことに伴い、2020 年 4 月 2 日付吸収分割に係る事前開示書面に変更が生じたので、会社法施行規則第 183 条第 7 号に基づき、下記の項目につき、変更後の事項を開示いたします。なお、項目番号は 2020 年 4 月 2 日付吸収分割に係る事前開示書面の項目番号と対応しております。

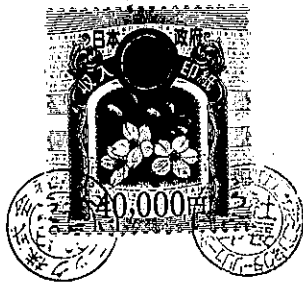
記

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1 項）

以下の事項を追加いたします。

「当会社は、本件分割の承継対象権利義務の一部を変更するため、2020 年 5 月 18 日付で、分割承継会社との間で本件吸収分割契約に係る吸収分割契約変更契約を締結いたしました。内容は別紙「吸収分割契約変更契約」のとおりです。」

以上



吸収分割契約変更契約

パナソニック株式会社（以下「甲」という。）及びパナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社（以下「乙」という。）は、甲及び乙の間で2020年3月26日付で締結した吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」という。）の変更について、以下のとおり吸収分割契約変更契約（以下「本変更契約」という。）を締結する。

第1条（本吸収分割契約の変更）

本吸収分割契約別紙の本文第1項（承継資産・権利）第1号について、下線部分を追加し、以下のとおり改める。

「乙及びパナソニック デバイスシステムテクノ株式会社において管理されている甲の所有に係る知的財産権（別添2のリストに掲げるもの及びそれらと優先権主張の基礎を同一とする日本国内外の特許出願を除く。）のうち、主として本事業において使用されており、主として本事業で使用する目的で保有されており、又は本事業にとって重要なものとして管理されている全ての知的財産権（当該知的財産権に係る甲が有する第三者に対する損害賠償請求権、不当利得返還請求権及び補償金請求権がある場合は、それらを含む。）

第2条（変更の効力）

本変更契約は、本吸収分割契約の不可分の一部をなし、本変更契約により変更、修正又は追加されたものを除き、本吸収分割契約の他の規定は引き続き効力を有するものとする。本変更契約締結日より、本吸収分割契約における「本契約」との文言は、本変更契約によって変更された本吸収分割契約を意味するものとする。

（以下余白）

本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、各当事者が、それぞれ署名又は記名押印の上、各 1 通を保有する。

2020 年 5 月 18 日

甲：パナソニック株式会社

代表取締役

津賀一宏



2020年5月18日

乙： パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社
代表取締役 小山 一弘



承継対象資産・権利から除外する知的財産権のリスト

"出願国 Country"	"出願番号 Appl. No."
Japan	2009-219857
United States of America	12/838849
Japan	2009-244046
United States of America	12/839778
United States of America	13/766446
Patent Cooperation Treaty	PCT/JP2018/044775
Japan	2019-562913
Patent Cooperation Treaty	PCT/JP2018/030862
China	201880057222.3
Japan	2019-540869
United States of America	16/806928
Patent Cooperation Treaty	PCT/JP2018/032676
China	201880057233.1
Japan	2019-540951
United States of America	16/809359
Patent Cooperation Treaty	PCT/JP2018/031899
Taiwan	107130812
China	201880057229.5
Japan	2019-540910
United States of America	16/808290
European Patent	18854563.6
Patent Cooperation Treaty	PCT/JP2018/031298
Taiwan	107130584
China	201880057223.8
Japan	2019-540878
United States of America	16/809365
European Patent	18853797.1
Japan	2018-241679
Japan	2020-010097

